

Qualitative und quantitative Analysen dünner Funktionsschichten für das Kleben durch XPS-, AES-, REM- und TEM-Untersuchungen

PRODUCT
Image
Unavailable



Die Schwachstelle aller Klebverbindungen ist die Grenzschicht zwischen Klebstoff und Substrat. Aus diesem Grund ist eine Optimierung hinsichtlich Klebstoffauswahl und Oberflächenvorbereitung/- vorbehandlung des Substrats unerlässlich, um definiert und sicher zu kleben. Das Ziel des aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) geförderten FuE-Projekts (Nr. IW 050136) bestand darin, Klebverbindungen hinsichtlich ihrer Alterungs- und Korrosionsbeständigkeit durch Aktivierung der Oberfläche mittels Funktionsschichten zu verbessern, um das Kleben auch für kleine und mittelständische Unternehmen attraktiver zu machen. In der vorliegenden Veröffentlichung werden Ergebnisse aus diesem Forschungsprojekt zu analytischen Untersuchungen der durch das Silicoater- beziehungsweise Pyrosil®-Verfahren hergestellten Schicht mit Schichtdicken im Nanometerbereich vorgestellt.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 2,34 €

2,50 €

Netto-Preis: 2,34 €

Enthaltene MwSt.: 0,16 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)